

品種		性状	平均粒径(μm)		成分(%)			主な用途
			ブレーション径	レーザー回折散乱	TREO*	CeO <sub>2</sub> /TREO	F	
MIREK HL	HL05	粉末	0.3~0.5	0.5~0.9	90~97	50~70	1~15	最終仕上げ用
	HL10		0.5~0.7	0.8~1.2				最終仕上げ用
	HL21		0.7~1.0	0.9~1.4				最終仕上げ用
	HL30		1.0~1.2	1.2~1.7				1次研磨用
	HL40		1.2~1.7	1.7~2.5				1次研磨用

※TREO = Total Rare Earth Oxide